**113學年度(2024)專題製作分組確認單**

以下為分組名單，請確認無誤，期末將以此為評分名單。

請組員與指導老師討論填寫專題題目，勾選報告分組類別。

本單請於113/08/21(三)16:00前繳交給系辦助教；逾期繳交，113(1)專題製作期末成績不予計算。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指導老師** | **班級** | **學號** | **姓名** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**專題題目名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**報告分組別：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **勾選** | **組名** | **說明** |
|  | 資訊應用組(IP) | ICT創新應用、智慧製造、區塊鏈、IoT、AI、大數據、ODF、雲端應用、行動應用、行動支付、智慧聯網、資訊安全、AR/VR、5G、電子商務…等。 |
|  | 產學合作組(PR) | 與產業界簽訂「專題產學合作同意書」，針對共同關心的主題合作完成之專題者。ICT創新應用、智慧製造、區塊鏈、IoT、AI、大數據、ODF、雲端應用、行動應用、智慧聯網、資訊安全、AR/VR、5G、電子商務…等。**合作廠商**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**指導教授簽名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**